

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 1 区分

【発行日】平成24年11月8日(2012.11.8)

【公開番号】特開2008-180713(P2008-180713A)

【公開日】平成20年8月7日(2008.8.7)

【年通号数】公開・登録公報2008-031

【出願番号】特願2008-9962(P2008-9962)

【国際特許分類】

G 0 1 T 1/24 (2006.01)

A 6 1 B 6/03 (2006.01)

H 0 1 L 31/09 (2006.01)

G 0 1 N 23/04 (2006.01)

【F I】

G 0 1 T 1/24

A 6 1 B 6/03 3 2 0 R

H 0 1 L 31/00 A

G 0 1 N 23/04

【手続補正書】

【提出日】平成24年9月24日(2012.9.24)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

二次元アレイに配列された複数の金属化アノード(102)であって、各々の金属化アノード(102)が間隙(125)により他の金属化アノード(102)から離隔されている、複数の金属化アノード(102)と、
該複数の金属化アノード(102)に電気的に結合されている直接変換物質(101)であって、当該直接変換物質(101)に入射するX線により発生される電荷が前記複数の金属化アノード(102)の少なくとも2個の間で共有される複数の電荷共有領域(124)を有する直接変換物質(101)と、
前記電荷共有領域(124)に向かうX線を減弱するように配置されているX線減弱物質(110)の交差する栈材(114、116)の二次元グリッドと
を備えた計算機式断層写真法(CT)検出器。

【請求項 2】

前記X線減弱物質(110)は、タングステン、モリブデン、鉛、並びにタングステン、モリブデン及び鉛の一つで充填されたポリマーの一つである、請求項1に記載の計算機式断層写真法検出器。

【請求項 3】

前記X線減弱物質(110)と前記直接変換物質(101)との間に配置された高電圧絶縁物質(119)をさらに含んでいる請求項1に記載の計算機式断層写真法検出器。

【請求項 4】

前記高電圧物質(119)と前記直接変換物質(101)との間に配置されており、前記高電圧絶縁物質(119)の表面に付着されている金属化表面(120)をさらに含んでいる請求項3に記載の計算機式断層写真法検出器。

【請求項 5】

前記直接変換物質（１０１）と前記Ｘ線減弱物質（１１０）との間に配置されており、前記直接変換物質（１０１）の表面に付着されている金属化表面（１０８）をさらに含んでいる請求項１に記載の計算機式断層写真法検出器。

【請求項６】

隣り合った前記木材（１１４、１１６）の間に配置されている低Ｘ線減弱性の構造材（１２２）を含んでいる、請求項１に記載の計算機式断層写真法検出器。

【請求項７】

前記二次元グリッド（１１０）の前記木材（１１４、１１６）に実質的に整列しているプレート（１９）の二次元パターンを有する散乱線除去コリメータ（１２８）をさらに含んでいる請求項６に記載の計算機式断層写真法検出器。

【請求項８】

焦点スポットと、対応する電荷共有領域（１２４）との間に延在する射線と同一線上に各々配置されている複数の散乱線除去ブレード（１９）をさらに含んでいる請求項６に記載の計算機式断層写真法検出器。

【請求項９】

前記二次元グリッド（１１０）は、前記複数の金属化アノード（１０２）により形成される間隙（１５２）のパターンに実質的に一致するパターン（１５０）を形成する、請求項６に記載の計算機式断層写真法検出器。

【請求項１０】

前記グリッドにより形成される複数の開口（１７６）の各々が、前記直接変換物質（１０１）の４個のピクセル（１０２）を包含する、請求項９に記載の計算機式断層写真法検出器。